JPCA 2027 Show
第56回国際電子回路産業展

JIEP 2027 マイクロエレクトロニクスショー
第41回 最先端実装技術・パッケージング展

JISSO PROTEC 2027
第28回 実装プロセステクノロジー展

CORE TECHNOLOGIES Expo
AI・光電融合要素技術展

～装置と装置をつなぐ～
WIRE Japan Show 2027
電気・光伝送技術展

Electronics Component & Unit Show
JEP 全国電子部品流通連合会
東京都電機卸商業協同組合

E-Textile/Wearable
イーテキスタイル／ウェアラブル展

OSAT SOLUTION SHOW



2027.6.2 Wed. → 4 Fri. 東京ビッグサイト東展示棟・会議棟

電子機器2027 トータルソリューション展

The Total Solution Exhibition for Electronic Equipment 2027

出展のご案内

出展申込受付開始 2026年11月2日(月)10:00～

展示会公式サイトへ

主催：一般社団法人日本電子回路工業会、一般社団法人エレクトロニクス実装学会、
一般社団法人日本ロボット工業会
共催：電子デバイス産業新聞［(株)産業タイムズ社］、電線新聞［(株)電線新聞社］、
全国電子部品流通連合会／東京都電機卸商業協同組合、
一般社団法人日本OSAT連合会
後援（予定）：経済産業省

海外協力：世界電子回路業界団体協議会(WECC)加盟団体
中国電子電路行業協会(CPCA)、欧州電子回路協会(EIPC)、インド電子工業会(ELCINA)、
香港線路板協会(HKPCA)、グローバル・エレクトロニクス・アソシエーション(GEA)、
インド電子回路工業会(IPCA)、韓国 PCB 半導体パッケージング産業協会(KPCA)、
タイ電子回路工業会(THPCA)、台湾電路板協会(TPCA)
Korea Packaging Integration Association-JKC(KPIA)

2026/10/21版

未来って、なんでできてる？

― 半導体・基板・実装から、AI時代の電子機器まで ―

電子機器トータルソリューション展 2027では、半導体、パッケージ、電子回路基板、実装、材料、装置、電子部品から電子機器まで、
エレクトロニクスの未来を支える幅広い分野の技術・製品が一堂に集まります。
新規構成展「AI・光電融合要素技術展」を開催。AI並びに光電融合を支える要素技術が集結！

開催概要

会　期　2027年6月2日(水)～6月4日(金)　午前10時～午後5時

会　場　東京ビッグサイト 東展示棟・会議棟

入 場 料　1,000円(税込) ※WEB登録で無料

本部事務局　一般社団法人 日本電子回路工業会(JPCA)

運営事務局　株式会社パワープロジェクト

構成展示会・出展対象

電子回路技術

JPCA 2027 Show
第56回国際電子回路産業展

主催:一般社団法人日本電子回路工業会

- **プリント配線板技術展**
  電子回路基板に関する製品・技術全般(設計・シミュレーション、信頼性・検査、基板材料、機能・プロセス材料、製造装置、関連システム、等)
- **半導体パッケージング・部品内蔵技術展**
  モジュール基板／モジュール基板実装／部品内蔵基板・部品内蔵に関する製品・技術全般(設計・シミュレーション、信頼性・検査、基板材料、機能・プロセス材料、製造装置、関連システム、等)
- **フレキシブルプリント配線板製品出展エリア**
  フレキシブルプリント配線板に関する製品・技術全般(設計・シミュレーション、信頼性・検査、基板材料、機能・プロセス材料、製造装置、関連システム、等)
- **機器・半導体受託生産システム展**
  EMS・ODM及び半導体の受託生産に関するサービス・技術全般(設計・シミュレーション、信頼性・検査、材料、機能・プロセス材料、製造装置、関連システム、等)

高密度実装技術

JIEP 2027 マイクロエレクトロニクスショー
第41回 最先端実装技術・パッケージング展

主催:一般社団法人エレクトロニクス実装学会

実装・電子技術に関する技術全般
(材料／回路・実装設計／高速高周波／電磁特性／電子部品・実装／光回路実装／環境調和型実装／半導体パッケージ／マイクロメカトロニクス実装技術／各種関連製造装置、等)

電子部品実装技術

JISSO PROTEC 2027
第28回 実装プロセステクノロジー展

主催:一般社団法人日本ロボット工業会

- **電子部品実装機および関連機器・システム**
  電子部品装着機(マウンタ)、電子部品挿入機(インサータ)、クリームはんだ印刷機、はんだ付け装置(リフローオーブン)、ディスペンサ
- **実装関連機器・システム**
  搬送システム、AGV、自動倉庫、テーピングマシン・材料、バルクフィーダ・その他フィーダ、自動組立装置、レーザーマーキング装置、洗浄装置・洗浄剤
- **半導体実装機・システム**
  ボンディング装置、フリップチップ実装システム、COBシステム
- 産業用ロボット
  ハンドリングロボット、組立ロボット、搬送ロボット、AMR
- **検査・試験装置**
  基板外観検査装置、半導体製造関連検査・測定装置
- **実装設計システム**
  設計ツール生産最適化ソフトウェア、実装プログラミング装置
- **実装デバイス・部品および関連材料**　**実装デバイス包装材**
- **実装接合システム・はんだ/接合材料**
- **高周波対応装置・部品・材料**　**環境関連装置・材料**

AI・光電融合要素技術

NEW CORE TECHNOLOGIES Expo
AI・光電融合要素技術展

共催:一般社団法人日本電子回路工業会、
電子デバイス産業新聞((株)産業タイムズ社)

AI データセンター、AI サーバー、次世代コンピューティングの高速・大容量・低消費電力化を支える要素技術を対象とします。

- **光電融合・Photonics**
  シリコンフォトニクス／光I/O／CPO・LPO／光トランシーバ／光スイッチ／レーザー・光デバイス／光導波路／光電気混載・光実装技術
- **AIコンピューティング・高速伝送**
  AI半導体／GPU・AIアクセラレータ／高速インターフェース／SerDes／高速伝送部品／EMI対策
- **先端パッケージ・実装**
  2.5D・3Dパッケージ／チップレット／インターポーザ／ガラス基板・ガラスコア基板／高密度実装・接合技術
- **高速・高周波基板・材料**
  高速・高周波・低損失基板／光電気混載基板／低誘電・高耐熱・放熱材料／次世代基板材料
- **電源・冷却・熱対策**
  電源モジュール／パワー半導体／DC-DC変換／バスバー／液冷・空冷／放熱・熱マネジメント技術
- **製造・設計・検査・評価**
  製造・実装装置／設計・EDA／シミュレーション／検査・計測／高速信号・光通信評価／信頼性評価　など

電気・光伝送技術

～装置と装置をつなぐ～
WIRE Japan Show 2027
電気・光伝送技術展

共催：一般社団法人日本電子回路工業会、電線新聞((株)電線新聞社)

ワイヤー・ケーブル等を用いる伝送技術全般
(産業用機器／電線・ケーブル及びコネクタ／電線加工機／配線用部材／ワイヤーハーネス／電線・ケーブル用計測器／各種装置／検査技術／装置間(M2M)伝送／光伝送等)

半導体・電子部品

Electronics Component & Unit Show
JEP 全国電子部品流通連合会
東京都電機卸商業協同組合

共催:一般社団法人日本電子回路工業会、全国電子部品流通連合会、東京都電機卸商業協同組合

半導体・電子部品等を用いたソリューション技術全般
(半導体／電子デバイス／センサー／機構部品／FA制御機器／計測器／電源／IoT・M2Mソリューション／もの作りソリューション・システム、等)

高機能テキスタイル

E-Textile/Wearable
イーテキスタイル／ウェアラブル展

主催：一般社団法人日本電子回路工業会

電子技術と繊維・衣料が融合するイーテキスタイル(スマートテキスタイル／ストレッチャブル技術／ウェアラブル技術)に関する技術全般
(繊維素材・材料／導電性素材・材料／編・織技術／プリント・マーキング技術／フィルム／センサー／信頼性検査／関連装置・システム、等)

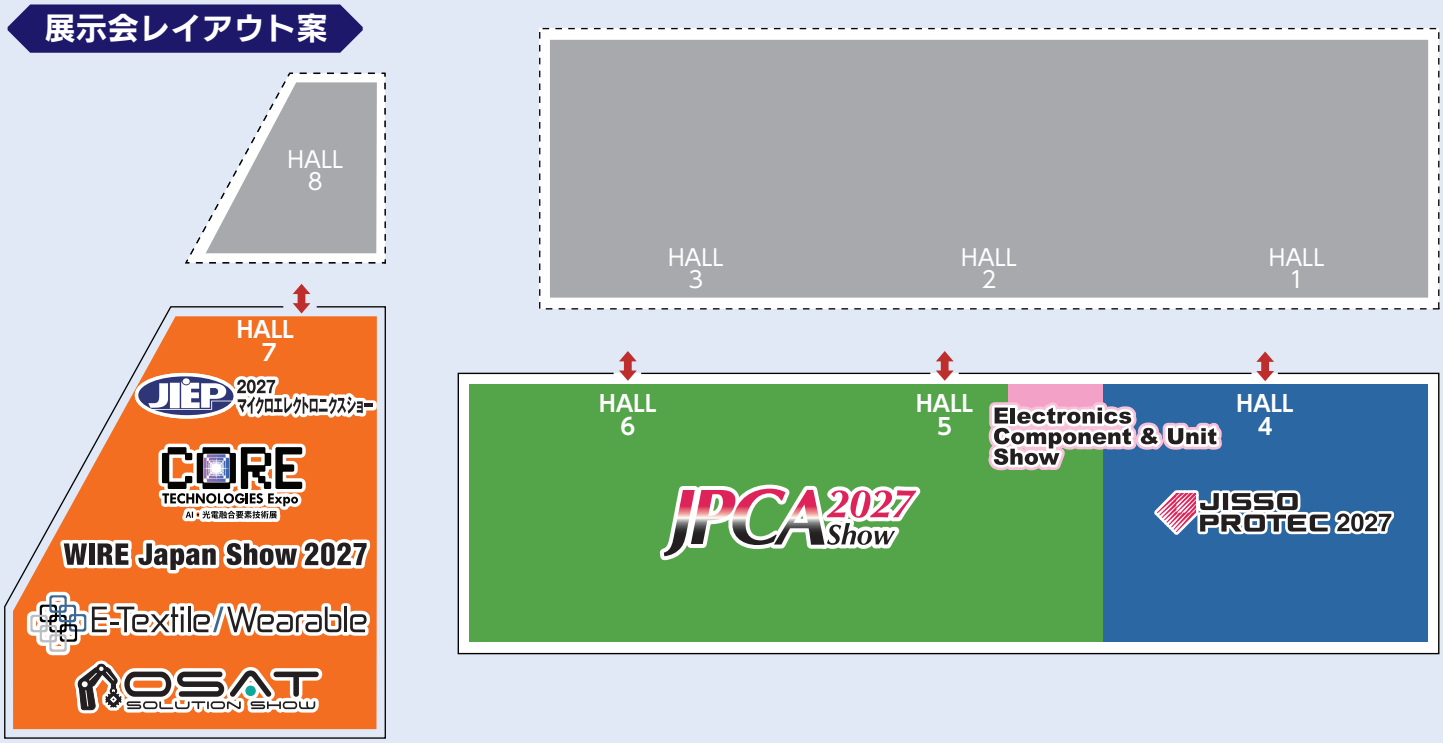
半導体後工程

OSAT SOLUTION SHOW

共催：一般社団法人日本電子回路工業会、一般社団法人日本OSAT連合会

半導体後工程に関する技術・材料・装置全般
(パッケージ材料、アセンブリ設備、ウェハレベルパッケージ、ファンアウト型パッケージ(FO-WLP、FO-PLP)、3D/2.5D実装、チップレット、PLP、テストシステム、ハンドリング設備、パッケージ設計ツール、シミュレーター、等)
半導体後工程に関する商社、団体、他

展示会レイアウト案



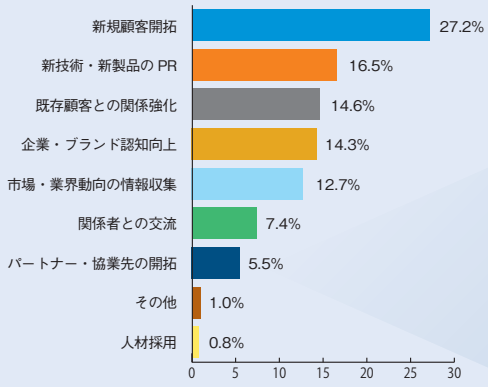
2026年展実績

会場 東京ビッグサイト 東展示棟　1~3ホール、7ホール・会議棟

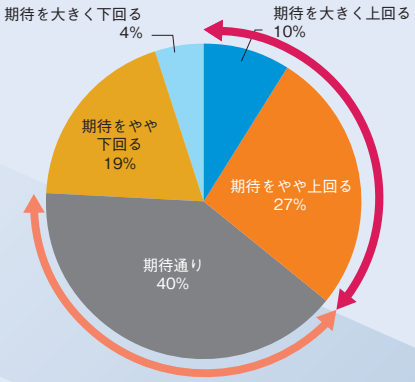
出展規模 534社 / 1,373小間　**来場者数** 49,206名

●出展者アンケート

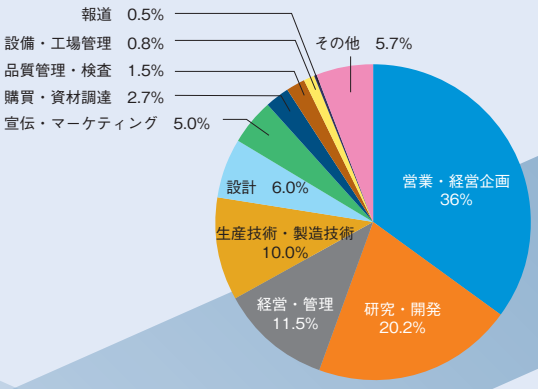
①出展目的（複数回答）



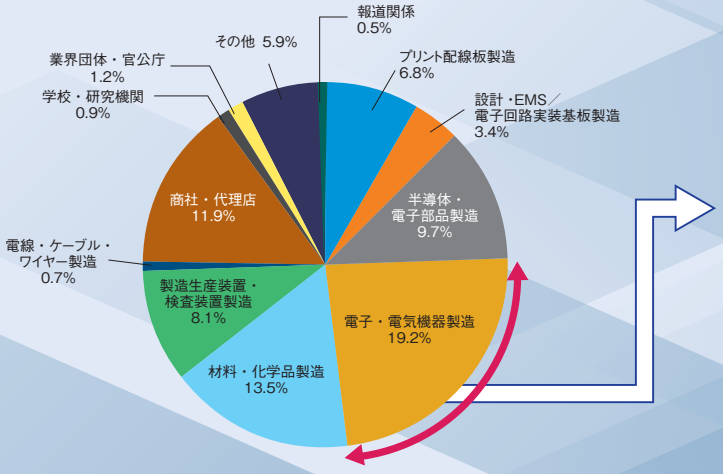
②出展成果

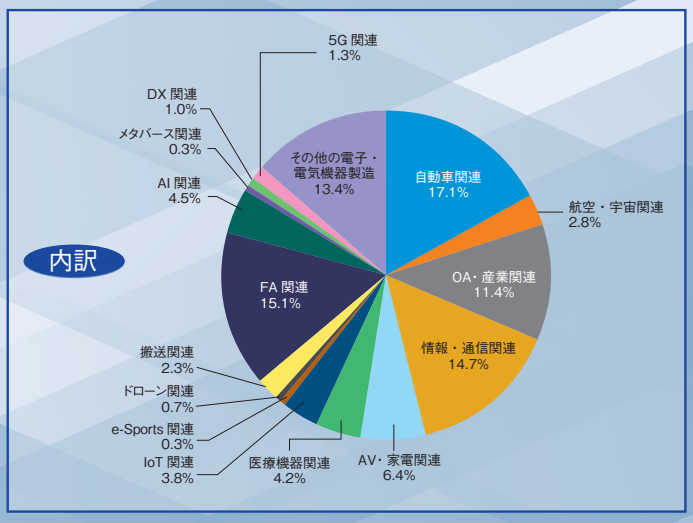


●来場者職種分類



●来場者業種分類





本展は総合展示会のため電子機器に関する幅広い業種の方々に来場いただき、なかでも電子・電気機器製造の方が多い。特に情報通信関連、ファクトリーオートメーション関連の伸びが大きい。また、製品分類においては、プリント配線板製品、電子回路実装基板製造、半導体パッケージング製品への関心が高い。

出展料金

区　分		1小間 / 9m²
一　般		498,300円（税込）
会員 *1	通常	424,600円（税込）
	早期	398,200円（税込）
	20小間以上	372,900円（税込）

*1 対象：JPCA会員／JIEP賛助会員／JARA正会員・賛助法人会員／JEP・TEP正会員／J-OSAT正会員・賛助会員

※1小間のサイズは、3m×3m=9m²です。

※小間設営・装飾費、電気・給排水、小間内清掃費、廃棄物処理費などの工事費および使用料は含まれていません。

出展申込（2026年11月2日（月）10:00～受付開始）

展示会ウェブサイトよりオンラインでお申込みください。（**www.jpcashow.com**）
貴社の出展製品・技術・サービスに応じて、ご出展構成展をお選びいただき、必ず、「出展規約」をご確認ください。
専用の出展申込書が用意されている展示会については、当該の出展規約が適用されます。
出展申込書を受理後、請求書を発行しますので、記載の期日までにお振込みをお願いします（原則会期前振込）。

申込締切

早期申込締切日（対象：会員企業）	2027年1月29日（金）
最終申込締切	2027年2月26日（金）

※早期料金・対象については出展料の欄をご確認ください。
※予定の小間数に達した場合、締切らせていただくことがありますので、予めご了承ください。

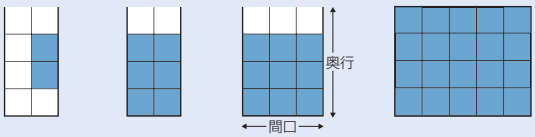
取消料

出展申込者の都合により出展を取り消す場合（全てまたは一部）下記の通り取消料を申し受けます。

書面による取消通知を受理した日	取消料
～2月26日（金）	小間料金の　30%
2月27日（土）～3月31日（水）	小間料金の　50%
4月1日（木）～4月30日（金）	小間料金の　70%
5月1日（土）～	小間料金の100%

小間形態

（A）直列小間タイプ　（B）ブロック小間タイプ（4小間以上）　（C）独立小間タイプ（20小間以上）



※小間タイプのご希望に添いかねる場合もありますので、予めご了承ください。

小間位置の決定

小間位置選択会（2027年3月下旬開催予定）にて小間位置を決定いたします。
原則、同一展示会における同一申込小間数、小間形態、機能別展示会技術テーマ等を考慮した展示会レイアウトに基づき、出展申込順で選択順位を決定します。
※詳細は出展規約をご確認ください。

出展者サポートプログラム　有料・オプション

来場者データ取得サービス、各種広告プラン等出展の効果を高めるプログラムをご用意します。
※詳細は別途出展者説明オンデマンド（2027年3月中旬公開予定）でご案内します。

パッケージブースプランのご案内　有料・オプション

●1小間ベーシックプラン（予定）
価格（予定）：￥121,000（税込）
最低限必要なブース造作、電源、カーペットなどが付属したプランです。詳細は出展者説明オンデマンド（2027年3月中旬公開予定）にて配布する資料をご確認ください。



開催までのスケジュール

2026年11月	2027年1月	2月	3月	4月	6月
▲ 11月2日(月) 10:00 出展申込受付開始	▲ 1月29日(金) 出展早期申込締切 （対象：会員）	▲ 2月26日(金) 出展最終申込締切	▲ 3月中旬 出展者説明オンデマンド公開 出展者マニュアルの公開 ▲ 3月下旬 小間位置選択会開催	▲ 4月中旬 招待状発送 来場登録開始	▲ 5月31日(月)～ 6月1日(火) 搬入期間 6月2日(水)～4日(金) 展示会開催 ※最終日即日撤去

3月中旬～5月下旬
各種提出書類の締切

お問い合わせ・資料請求受付

運営事務局　株式会社パワープロジェクト
〒101-0047　東京都千代田区内神田1-8-11　東京保井ビル6F
TEL：03-6823-1414　E-mail：jpca@powerproject.co.jp

展示会公式サイトへ